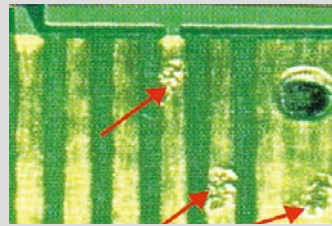


【Characteristics】 A edge board contact area is dented by an electrical test probe.

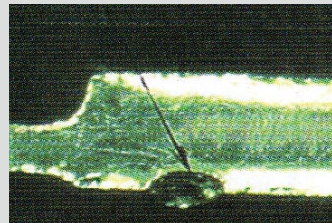
【原因・判断ポイント・発生工程】電気導通検査時に、プローブピンの曲がり、錆付き、異物噛込みなどにより、プローブピンが端子表面へ強く当たったり、引きずったりして出来たもの（電気導通検査工程）

【原因、判断要点、发生工序】在通断测试时，因为探测针弯曲、氧化、咬入杂物等，测试针顶撞或者摩擦插脚表面所引起的（通断工序）。

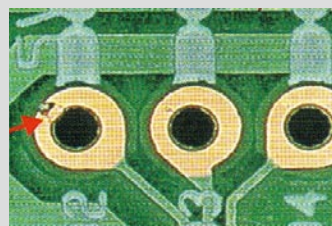
【Causes/processes involved/keys to judgment】
The surface of edge board contact is hit hard or scratched by a bent or rusted probe or a probe including a foreign object in electric conduction testing, causing the defect. (Open/short testing)



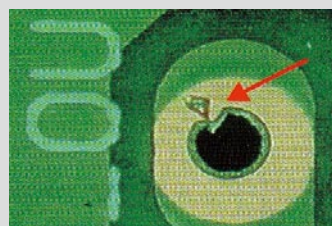
【コメント】
顕微鏡倍率×
【注釋】
显微镜倍率 ×
【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率×
【注釋】
显微镜倍率 ×
【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率× 40
【注釋】
显微镜倍率 × 40
【Comments】
Magnification: ×40



【コメント】
顕微鏡倍率× 60
【注釋】
显微镜倍率 × 60
【Comments】
Magnification: ×60

7-4-3 ストリップコート穴内残り／可剥离膜残留在孔内 / Strip coat residue in hole

【特徴】 ストリップコートがスルーホールなどの中に残っている状態の欠陥

【特征】 可剥离膜残留在通孔内等的缺陷。

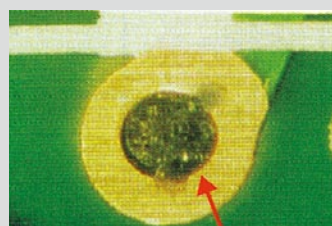
【Characteristics】 Strip coat remains in a through-hole.

【原因・判断ポイント・発生工程】 ストリップコートの乾燥条件不適や、ストリップコート印刷時の粘度不適などにより、穴潜り量が過剰となり出来たもの（ストリップコート印刷工程）

【原因、判断要点、发生工序】 由于可剥离膜的烘干条件不合适、或者可剥离膜的粘度不合适等，在孔的潜入量过剩而引起的（可剥离膜印刷工序）。



【コメント】
顕微鏡倍率×
【注釋】
显微镜倍率 ×
【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
左の拡大
顕微鏡倍率×
【注釋】
左的放大
显微镜倍率 ×
【Comments】
Enlargement of left photo
Magnification: ×